

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年9月7日(07.09.2023)



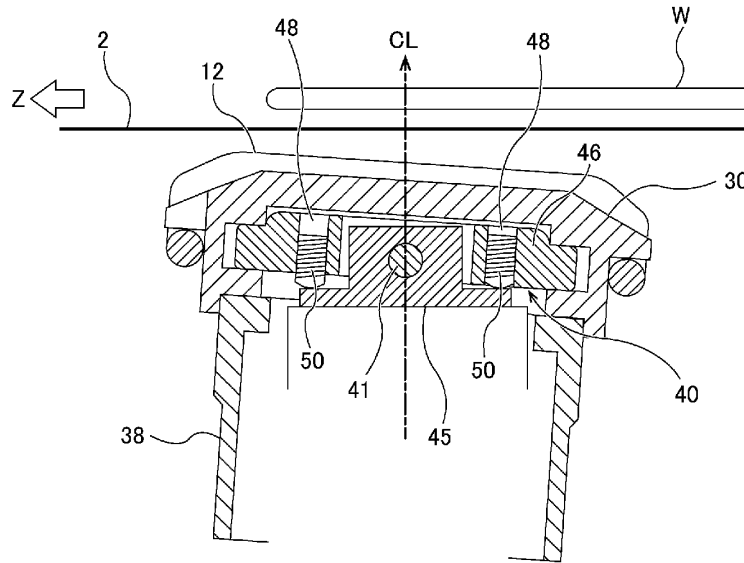
(10) 国際公開番号

WO 2023/166986 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 21/00 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 21/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/005147
- (22) 国際出願日: 2023年2月15日(15.02.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-030585 2022年3月1日(01.03.2022) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (**EBARA CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 柏木 誠 (**KASHIWAGI, Makoto**); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
藤澤 真於 (**FUJISAWA, Mao**); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (**HIROSAWA, Tetsuya et al.**); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: POLISHING HEAD AND POLISHING DEVICE

(54) 発明の名称: 研磨ヘッドおよび研磨装置



(57) Abstract: The present invention pertains to a polishing head for pressing a polishing tape against a substrate such as a wafer. The present invention also pertains to a polishing device for polishing a substrate using such a polishing head. A polishing head (10) comprises a pressing member (12) that presses a polishing tape (2) against a substrate (W), an actuator (15) that moves the pressing member (12) in a predetermined pressing direction (CL) and applies a pressing force to the pressing member (12), and a tilt adjusting mechanism (40) that adjusts the tilt of the pressing member (12) with respect to the pressing direction (CL). The tilt adjusting mechanism (40) is configured to tilt the pressing member (12) with respect to the pressing direction (CL) and keep the angle of the tilted pressing member (12).

WO 2023/166986 A1

[続葉有]

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE,
KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 本発明は、ウェーハなどの基板に研磨テープを押し付けるための研磨ヘッドに関するものである。また、本発明はそのような研磨ヘッドで基板を研磨するための研磨装置に関するものである。研磨ヘッド(10)は、研磨テープ(2)を基板(W)に対して押し付ける押圧部材(12)と、押圧部材(12)を所定の押圧方向(CL)に移動させ、押圧部材(12)に押圧力を付与するアクチュエータ(15)と、押圧方向(CL)に対する押圧部材(12)の傾きを調整する傾き調整機構(40)を備える。傾き調整機構(40)は、押圧部材(12)を押圧方向(CL)に対して傾け、傾いた押圧部材(12)の角度を保持するように構成されている。